



AMERICA'S LARGEST INNOVATION EXPOSITION

# SILICON VALLEY INVENTION FESTIVAL

BACK TO THE STAGE  
USA, CALIFORNIA, SANTA CLARA CONVENTION CENTER  
26-28 JULY 2024

Registration Deadline  
31 May 2024



@SVIIF2024

[WWW.SVIIF.COM](http://WWW.SVIIF.COM)



# 2024 美國矽谷國際發明展

## 邀請函

發明先進：敬啟

美國是我國最大的貿易市場，每當有新產品問市，莫不以進入美國市場為第一考量，今年美國 SVIIF 即將在七月開展，本會將組團參加，盼有新產品之發明人或廠商，欲獲取美國市場者，美國矽谷國際發明展將是一項最佳選擇，想藉由參加此大展吸取經驗者，千萬不要錯失這一年一度的發明展出盛會。

往年美國發明展展出時，全球各地工商人士都前往參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，您有可能一夕之間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明家的新作品以予學習改進參考，一舉數得。

今年我們除了傳承以往的優點外，本屆展覽預計有廿餘國參展，敬盼與您同行。

**2024 年 SVIIF 於 7 月 26 日 ~ 7 月 28 日**

**假聖克拉拉會議中心舉行**

**即日起接受報名至 5 月 31 日截止**

**(出團人數額滿亦提前截止)**



台灣發明協會  
美國矽谷參展團

團長 **張家菊** 敬邀

# SIF 2024 美國矽谷國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力、促進國際科技交流、爭取國家榮譽、增進國民外交、拓展發明新產品海外市場及提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟協會(IFIA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2024 美國矽谷國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：美國矽谷國際發明展大會組團授權書
- 六、展覽會名稱：Silicon Valley International Invention Festival 2024
- 七、展出日期：2024 年 7 月 26 日至 7 月 28 日
- 八、展出地點：USA, California, Santa Clara Convention Center  
5001 Great America Pkwy, Santa Clara, California 95054, United States

## 九、費用：

1. 國內報名費：**台幣 5,000 元**(限同參展人/學校/公司)
2. 個人旅費：**台幣\_\_\_\_\_元** (包含來回機票、食宿及美國 10 日遊)  
(不含 2% 刷卡手續費及司機導遊小費)
3. 參展攤位費：  
面積  $3^m \times 3^m$ ，每件**台幣 59,400 元**。(同一攤位上，至多可再增加 2 件發明品，每增加展出一件發明品，加收**台幣 19,800 元**)
4. 其他費用：
  - ① 參展品運送費用另計。(自行處理者免)
  - ② 參展者不克前往，需委由主辦單位代理參展者，需另加收代理費一萬元/攤。(不含其他參展費用)
  - ③ 參展品之海報、專刊費用**台幣 4,000 元/件**。(需統一製作)
  - ④ 展覽會場之現場翻譯費、電源費用另計。

※ 指定轉角攤位者須多加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

※ 同一發明人/公司/學校，一攤位可展三件作品，依此類推。

※ 每攤位含一桌二椅，不含電源。

※ 截止日前，參展資料未繳交齊全者，將無法於美國展覽大會專刊刊登。

攤位示意圖：





## 繳交參展資料明細單：

請以電子檔文件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入□□□(個人名、學校名或公司名)報名美展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔文件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便雙方核對或通知補件，謝謝。

- 1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)  
含產品介紹中、英文(約 150 字左右)
- 2. 切結書(請由該件作品一位發明人代表簽名或蓋章)
- 3. 參展品專利證書檔案或申請中收據(無專利者免附)
- 4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張，圖片周圍請盡量不要留白。)
- 5. 隨團前往參展人員請附上隨團參展表(含護照影本)
- 6. 發明人或聯絡人名片
- 7. 聘請翻譯人員切結書(無聘請者免填)

報名日期：即日起接受報名至 **5月31日截止**(出團人數額滿亦提前截止)

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

- 以上資料請於報名截止日前，連同訂金 **20,000 元/攤**，mail 至本會，以先完成報名手續。
- 欲索取估價單者，請發 mail 至本會，並告知：單位名、攤位數、作品件數、幾人隨本團參展、是否用電或聘幾天翻譯。
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行  
戶名：“**台灣發明協會**”。 帳號：“**0310-10-100304-3**”。



台灣發明協會  
官方好友 LINE